

证券代码：301095

证券简称：广立微

# 杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 线上交流 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	投资者网上提问
时间	2023年3月30日(周四)下午15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )采用网络远程的方式召开业绩说明会
公司接待人员	董事长、总经理：郑勇军 财务负责人、董事会秘书：陆春龙 独立董事：朱茶芬 中金公司 投资银行部执行总经理、保荐代表人：程超
交流内容及具体问答记录	<p><b>一、基本情况介绍</b></p> <p>公司董事长郑勇军先生就公司最新业务发展情况做了基本介绍，财务负责人、董事会秘书陆春龙先生就公司经营情况做了基本介绍：2022年，公司年度共计实现营业收入额为35,559.98万元，同比增长79.48%，近三年复合增长率为69.42%。在净利润方面，2022年度实现归母净利润12,237.49万元，同比增长91.97%，近三年复合增长率为56.65%，实现归母扣非净利润10,271.57万元，同比增长104.01%，近三年复合增长率为64.55%。</p> <p><b>二、问答环节</b></p> <p>1、作为一家以研发为生命的企业，请问公司在保障人才稳定性</p>

方面有哪些举措？

尊敬的投资者您好，公司较为注重人力资源的科学管理，创建了较为完备的人才培养与储备体系，制定了较为合理的员工薪酬方案及有效的绩效管理体系，并将持续采用符合法律法规要求的各种激励方式进一步加强核心人员的凝聚力。感谢您的关注！

**2、公司已经开展数据软件产品由试用转向商务采购的工作了吗？进度和成果如何？**

尊敬的投资者您好，公司目前的数据软件产品矩阵已初具规模，产品在多家集成电路企业试用并取得良好反馈，并逐步进入商务落地阶段，将为公司软件业务的增长提供新的驱动力，公司客户群体也将由集成电路制造公司为主逐步覆盖至芯片设计公司和封测厂。感谢您的关注！

**3、公司业绩增长还是很喜人的，请问公司增长可持续吗？公司有什么举措来保持增长？**

尊敬的投资者您好，公司将持续加大研发投入，延伸布局公司软硬件产品生态。（1）不断精进新工艺成品率提升方案，助力新生工艺及特色工艺的开发，帮助制造企业提升竞争力；（2）深入拓展量产 PCM 方案，将先进监控方法和 EDA 工具从工艺开发环节向量产环节推进；（3）深化开发 DFM 相关 EDA 工具，丰富公司制造类 EDA 产品矩阵，中长期逐步完善制造类 EDA 解决方案；

（4）加速半导体数据分析系统的研发步伐，从数据管理分析到 BI 平台、智能化模块开发，深入扩展数据分析产品应用范围，促进相关产品订单快速落地；（5）持续扩展测试设备品类，完成 T4000 量产并积极拓展海内外市场，完成晶圆级可靠性（WLR）测试设备完整功能开发，同时进行产品市场拓展。综上，公司将秉承务实发展的经营理念，推进公司产品技术创新和可持续发展。感谢您的关注！

**4、目前国内，除了公司，还有哪些企业能够在成品率提升及电性监控领域提供全流程覆盖产品及服务？**

尊敬的投资者您好，公司是海内外极少数能够在成品率提升

及电性监控领域提供软硬件一体化、全流程解决方案的企业，目前暂未看到能够在该领域向市场提供 EDA 软件、量产 WAT 测试设备与半导体数据软件于一体的其他企业。感谢您的关注！

**5、陆总，您好！请问贵司是华为 EDA 合作伙伴吗？**

尊敬的投资者您好，公司的主要客户情况参见公司招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、发行人的销售情况和主要客户”之“（三）报告期各期前五大客户及销售情况”，及公司定期报告相关信息。经过多年的努力，公司的产品和服务受到了国内外一线厂商认可，公司也形成了由行业龙头企业组成的优质客户群体，涵盖了国际知名厂商、国内龙头 Foundry 厂商以及 Fabless 厂商。感谢您对公司的关注！

**6、董秘，您好！我来自大决策，Chiplet 技术缺乏相关的 EDA 工具链，以及完整且可持续性的生态系统。请问贵司的 EDA 软件是否满足支持 Chiplet 的设计制造需要？**

尊敬的投资者您好，公司的半导体数据分析软件可以支持封装厂中 Chiplet 相关芯片的数据分析需求，有效地提高客户的数据分析效率、节省成本；同时，公司正在探索成品率技术在 Chiplet 方向上的相关技术储备，研究测试芯片技术在先进封装上的应用以解决更复杂工艺带来的成品率缺失问题；近日，广立微作为贡献者成员加入 UCIE (Universal Chiplet Interconnect Express) 产业联盟，公司将积极参与相关标准的制定和配套 EDA 工具的研发，特别是充分利用公司深厚的技术积累，推动 3D 异构集成良率提升的系统化解决方案，通过在 Chiplet 领域的持续深耕，促进业务的快速增长。感谢您对公司的关注！

**7、国家集成电路产业基金二期有投资贵司吗？具体金额是多少？**

尊敬的投资者您好，公司首次公开发行股票过程中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司参与战略配售，根据 2022 年 8 月公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的《证券发行登记申报明细清单(战略配售)》计算，其持有公司发行后 1.7241%

的股份。感谢您对公司的关注！

#### **8、公司目前有没有找到合作伙伴共同开发 WAT 测试机产品？**

尊敬的投资者您好，公司长期深耕集成电路成品率提升领域，自 2010 年开始研发 WAT 电性测试设备，公司 WAT 测试设备相关核心技术均系自主研发，且经过多年的技术和经验积累，不断对设备进行优化提升。感谢您对公司的关注！

#### **9、作为国内唯一实现 WAT 电学测试大规模商业化的公司，公司认为这个优势的在业务竞争上的意义主要在哪里？**

尊敬的投资者您好，公司是国内最早聚焦于集成电路成品率提升领域的企业，多年来始终秉承持续技术创新的发展理念为客户不断创造价值、伴随客户成长，已然在业内形成了良好的口碑和知名度，树立了良好的品牌形象。WAT 测试设备是公司成品率提升全流程解决方案中的重要一环，为公司的系统性解决方案提供了极大的价值；公司在成品率提升和电性监控领域研发起步早，在行业内形成了一定的先发优势，有望抓住国内产业发展的浪潮快速扩展市场占有率，加速企业业绩增长；公司是海内外极少数能够在成品率提升及电性监控领域提供软硬件一体化、全流程解决方案的企业，软硬件相结合的解决方案构筑了更高的技术壁垒；在业务上具有软硬件协同的差异化优势，使产品之间能够相互引流、共同增长，例如 WAT 设备能够在业务上帮助公司的 EDA 软件从工艺开发环节扩展应用至量产环节，进一步扩大公司业务的市场体量。感谢您的关注！

#### **10、公司目前在软硬件协同上取得了什么成效**

尊敬的投资者您好！经过多年的发展，公司已经实现在成品率提升领域的全流程覆盖，包括用于测试芯片设计的 SmtCell、TCMagic 及 ATCompiler 等 EDA 工具、用于测试数据采集的 WAT 电性测试设备及高效快捷的半导体数据分析软件系统 DataExp，是市场上极少数规模化采用软硬件协同方案提供成品率服务的 EDA 公司。

在成品率提升领域，测试芯片设计、测试信号采集、测试数

据处理等各个环节之间相互依存、紧密联系, 并已形成有效闭环。公司拥有的全流程系统性的解决方案, 能使得各个环节相互配合, 提高效率。在设计阶段, 公司通过自主开发的 EDA 工具和电路 IP, 能够大幅度提升测试芯片的设计效率, 满足客户最大限度增加测试结构以达到精确抓取各类电性信号的需求。在测试阶段, 结合公司自主开发的 WAT 电性测试设备, 测试效率能得到显著提升。在分析阶段, 通过搭建的数据分析平台和专用数据分析工具, 客户能够快速处理海量测试数据, 进而全面掌握生产工艺参数和缺陷信息, 便于优化和提升良率。

此外, 公司软硬件产品配合使用能大幅提升测试效率, 全流程的产品及服务覆盖也使得公司各个环节的软硬件产品能够相互促进、互相引流, 在单一产品进入客户的供应体系后, 进一步降低了公司其他产品进入的认证难度, 最终实现软硬件产品成体系的生态化发展。

感谢您的关注!

**11、公司 2022 年营收同比增加近 80%, 请公司说明一下具体情况和原因。**

尊敬的投资者您好! 公司业绩的大幅增长得益于内外部两方面的驱动因素: 在内部驱动因素上, 公司多年来形成的全流程成品率提升业务闭环展现出了更高的技术价值和壁垒, 使公司的市场竞争力不断提升; 其次, 软硬件协同的差异化优势也逐渐凸显, 公司的 EDA 软件和电路 IP 相结合能够有效地提升测试芯片的面积利用率, 基于公司软硬件协同研发的优势, 若增加采购公司的 WAT 测试设备则能够在测试效率上实现成倍的提升, 有利于客户获取更高的成品率提升价值; 另一方面, 公司的 WAT 测试设备进入量产线, 能够带动公司的 EDA 设计软件扩展到量产环节, 不仅扩展了 EDA 软件的市场空间, 还使得各项业务之间相互引流, 实现协同增长; 再者, 全流程的产品生态使公司的业务扩展性更强, 公司新推出的半导体数据软件在客户端反馈良好, 预计未来也将成为公司业务增长的核心引擎。

在外部驱动因素上，国内晶圆厂的兴建为本土集成电路 EDA 供应商、设备供应商提供了更广阔的市场机遇，成品率提升技术是新产线实现高质量量产的关键要素，亦能够作为评估新设备和新材料的有效技术手段；同时，国内部分芯片设计企业的流片业务将由海外流片转为本土化流片，更换新的代工厂通常需要了解其制造工艺情况，并且根据制造工艺情况对设计进行优化，以实现更高的成品率和芯片性能，这也带动了市场对公司软、硬件产品的需求；此外，在集成电路产业自主化的背景下，国内集成电路产线的成品率亟待提升，能够为公司业务的扩展带来更多的机遇。感谢您的关注！

**12、公司产品下游应用是否会涉及 AI 芯片？AI 芯片对公司产品性能上要求会有什么不同？**

尊敬的投资者您好，公司长期专注于制造类 EDA，在芯片成品率提升领域形成了包括 EDA 软件、WAT 测试设备和半导体数据分析软件在内的全流程产品生态构建，产品应用场景覆盖逻辑、存储及 Flash 等各类芯片产品，AI 芯片属于下游应用场景之一。公司基础产品和底层技术可以应用于各类芯片产品，针对不同客户新产品和技术需求，公司会通过自主创新不断攻克技术难题，实现创新突破，以保持产品与技术水平在产业内的领先性。感谢您对公司的关注！

**13、请公司介绍一下当前的研发重点和研发进度，谢谢**

尊敬的投资者您好，2023 年我们将持续加大研发投入，延伸布局公司软硬件产品生态。通过不断精进新工艺成品率提升方案，助力新生工艺及特色工艺的开发，帮助制造企业提升竞争力。感谢您对公司的关注！

**14、外国对集成电路的进出口管理日趋严格，国产化加速势在必行，请问公司对此怎么看？有什么机会？**

尊敬的投资者您好，公司以助力国家集成电路产业发展为己任，未来公司将持续秉承自主创新的理念，不断加大研发力度，加快成品率技术相关软件的升级开发，同时不断扩充并布局制造

类 EDA 产品生态，以提升企业的核心价值和和市场竞争能力，赋能国家集成电路产业链的发展。感谢您的关注和鼓励！

**15、陆董秘：您好！2022 年一季度受疫情影响，今年一季度业绩比去年一季度同比增长，可以这么理解吗？谢谢！**

尊敬的投资者您好，公司 2023 年度的财务信息请您关注相关公告及定期报告。感谢您的关注！

**16、公司对上海华虹是否存在大客户依赖？公司是否有相关举措？**

尊敬的投资者您好，公司的主要客户情况参见公司招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、发行人的销售情况和主要客户”之“（三）报告期各期前五大客户及销售情况”，及公司“2022 年年度报告”之“第三节 管理层讨论与分析”。经过多年的努力，公司的产品和服务受到了国内外一线厂商认可，公司也形成了由行业龙头企业组成的优质客户群体，涵盖了国际知名厂商、国内龙头 Foundry 厂商以及 Fabless 厂商。在成品率提升领域中，由于公司与客户的合作涉及产线、工艺等众多核心要素，直接影响客户的生产效率和产品质量，因此公司在进入客户的供应体系并经过一定时间的合作后，能够和客户形成较为稳定的战略合作关系。而行业内领先的企业与公司合作能够带来一定的示范效应，帮助公司在未来进一步拓展客户群体。此外，公司获得业内优质企业的认可有助于公司品牌形象的建立，为公司未来进一步进行产品推广奠定了坚实的基础。随着公司产品的进一步丰富，公司正逐步实现对包括芯片设计公司、晶圆制造厂、封测厂在内的集成电路全产业链客户的覆盖。感谢您对公司的关注！

**17、目前公司的产品在芯片制造的哪些环节能带来良率提升？**

尊敬的投资者您好，公司的成品率解决方案能够在集成电路从设计到量产的产品周期内，主要应用于工艺开发、新设备或新材料的引入、新产品导入的工艺评估及量产后的工艺监控场景，帮助实现芯片性能、成品率、稳定性的提升；同时公司的产品与技术亦能够帮助晶圆厂的新建产线顺利投产、产线迁移提供整体

性的良率爬坡方案。综上所述，公司的产品和服务应用于芯片从设计至量产的全生命周期助力各阶段的成品率提升。感谢您的关注！

**18、作为一名持有公司股份不多的普通投资者，如何可以进入公司实地调研，应该怎样操作？**

尊敬的投资者您好，请您发送详实身份信息资料及持股情况至公司投资者关系邮箱，公司在核实您的身份信息及持股情况后及时回复您的邮件。在此，也提醒您按照法律法规相关要求在实地调研时提供本人身份证复印件、中登公司下载的证券账户开户办理确认单复印件，以及能够证明调研日或调研日前一工作日为股东的证明文件。感谢您对公司的关注！

**19、公司去年软件开发及授权的增速比测试设备及配件低多了，请问公司如何看待这两项业务的未来？**

尊敬的投资者您好！（1）测试设备及配件增速高于软件开发及授权原因：公司 WAT 测试设备自 2020 年在头部晶圆厂示范性应用验收通过后，近两年开始规模化进入晶圆厂量产线，且半导体设备具有单价高、一经验证通过后的推广周期相对短的特点，因此近两年呈现出高速增长的态势，公司 2022 年获得了主要客户批量订单采购，客户群体持续扩大，销售额高速增长；公司的软件业务去年平稳增长，主要原因在于软件产品形成后的规模化产出周期相对更长，且去年公司的软件开发业务受到国内先进工艺开发进程放缓、管控影响验收节奏等因素影响，整体增速低于硬件业务。（2）未来发展：从业务上看，公司软、硬件相互协同的解决方案价值愈发凸显，现已成为业绩快速增长的双轮驱动。未来公司将持续加大研发投入，积极进行产业前瞻布局，进一步巩固技术壁垒，形成新的业绩增长点。在软件方面丰富开发 DFM 相关软件，关注投资并购，中长期逐步完善制造类 EDA 生态布局，同时加速智能化数据系统开发，发挥产业数据价值助力集成电路智能制造，预计该块业务在 2023 年会有较大增长；在硬件方面，持续扩展测试设备产品品类，积极进行海内外市场推

广。由于设备产品具有单价高、推广周期短的特点所以目前公司的硬件业务占比升高，中长期看，随着公司制造类 EDA 及数据软件的规模效应逐步凸显，公司的软、硬件业务将会保持齐头并进的发展态势，以实现公司长远、稳健的可持续发展。感谢您的关注！

**20、公司去年测试设备及配件业务增同比增长 142%，请问是什么情况？**

尊敬的投资者您好！公司自研的 WAT 测试设备经过十余年的技术迭代和优化，产品性能已达业界领先水平，并得到国内众多晶圆制造厂和头部芯片设计公司的充分认可和肯定。2022 年度，公司获得主要客户的批量订单采购，新客户拓展顺利推进，客户群体持续扩大，市场占有率快速提升，营业收入额实现了高速增长。感谢您的关注！

**21、郑董事长：您好！2022 年营业收入同比增长 79%，净利润同比增长 91%，请问 2023 年营业收入和净利润是否能保持 50%以上的增长？谢谢！**

尊敬的投资者您好，公司届时财务信息请您关注公司相关公告及定期报告，感谢您的关注！

**22、国外晶圆厂建设进度会不会放缓？欧美制裁对公司会有什么影响？**

尊敬的投资者您好，公司软硬件相结合的全流程成品率提升解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内帮助企业实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。公司会持续密切关注行业内客户企业投资建设等动态，根据行业内客户企业的需求提供 EDA 软件、晶圆级电性测试设备、大数据分析软件以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案。感谢您对公司的关注！

**23、近日有媒体报道““华为称，内部芯片设计 EDA 工具团队联合国内 EDA 企业，共同打造 14nm 以上工艺所需 EDA 工具，基本实现了 14nm 以上 EDA 工具国产化，2023 年将完成对其全面验**

证。”，公司透露一下，合作方是你们吗？

尊敬的投资者您好，公司相关客户信息请您关注公司相关公告及定期报告，感谢您的关注！

#### **24、公司最近推出的 DMS 系统与之前的有什么区别？**

尊敬的投资者您好，公司研发的 DE-DMS 缺陷数据管理与分析系统，不仅能灵活兼容晶圆厂中不同型号的各类检测机台，也能高效处理各种缺陷数据。通过对缺陷数据的快速分析，用户可以跨 module 查找缺陷来源并预测良率杀伤率 (Kill Ratio&Yield Impact)。目前 DE-DMS 系统已在国内多个大型晶圆厂中得到应用，取得了良好的实际效果，获得用户的良好反馈。感谢您的关注！

#### **25、请介绍公司产业规划**

尊敬的投资者您好，公司是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，提供 EDA 软件、电路 IP、WAT 测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案，未来公司也将围绕主业积极进行业务扩展，补齐制造类 EDA、完善智能化数据系统产品，同时不断增加电性测试设备品类，构建贯穿集成电路全产业链的软硬件一体化产品生态。感谢您的关注！

#### **26、公司的 WAT 测试设备产品业务经营情况如何？**

尊敬的投资者您好，公司 WAT 测试设备在晶圆厂量产线验证成功后开始规模化销售，由于其具有单价高、一经验证通过后的推广周期相对短的特点，因此近年呈现快速增长的态势；在设备生产条件方面，公司充分考虑市场需求及订单量并做好生产规划，以应对客户订单的变化并按时完成对客户的高质量交货。感谢您对公司的关注！

#### **27、从收入结构上公司测试设备及配件占比大幅提升的原因是什么？未来是否还会进一步提升？硬件占比的提升会不会使得公司毛利率持续下滑**

尊敬的投资者您好，收入结构方面，2022 年度，以 WAT 测试设备为核心的硬件业务占比为 68.54%，以 EDA 工具为核心的

软件业务占比为 31.45%。WAT 测试设备产品获得主要客户的批量订单采购，客户群体持续扩大，营业收入额高速增长。软件业务增长速度相对平稳，虽然软件授权业务仍保持了快速增长，但软件开发业务受到国内先进工艺开发进程放缓、疫情影响验收节奏等因素影响，导致软件业务整体增速低于硬件业务，综合影响硬件业务占比有较大幅度提升。相较于软件业务而言，硬件业务毛利率水平略低，因此硬件业务比重的上升会导致整体毛利率水平下滑。

未来，随着公司软硬件业务协同效应的逐渐显现，良率提升方案进入量产监控领域，数据软件产品在客户端的 DEMO 验证完成，我们预计软件业务比重将稳步拉升，公司整体毛利率水平有望逐步回升。感谢您的关注！

#### **28、目前公司的研发策略是怎么样的？**

尊敬的投资者您好，公司以 EDA 点工具为研发起点，到构建出芯片成品率提升全流程解决方案；从主要专注于工艺开发环节，到目前的工艺开发与量产环节成品率提升方案的全覆盖。我们通过制造类 EDA、半导体数据软件、电性测试设备三大业务板块不断扩大公司业务的市场体量，助力业务持续多年的快速增长。未来，我们将构建贯穿集成电路全产业链的软硬件一体化产品生态，补全制造类 EDA、完善智能化数据系统产品，同时不断增加电性测试设备品类。感谢您对公司的关注！

#### **29、公司如何看待华大九天和概伦电子，公司的优于他们的竞争力在哪里？**

尊敬的投资者您好，公司自成立以来在集成电路成品率提升领域深耕多年，是国内外极少数在成品率提升领域做到全流程产品覆盖的企业。公司提供 EDA 软件、WAT 测试设备和半导体大数据平台相结合的全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。公司解决方案已成功应用于 180nm~3nm 工艺技术节点，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司产品与华大九

天、概伦电子的 EDA 产品应用领域有所不同，详细介绍请您查阅其在深交所创业板、上交所科创板网站及相关法批媒体披露的招股说明书。感谢您的关注！

### **30、公司目前的核心专利是什么？**

尊敬的投资者您好！广立微始终秉承自主创新的研发理念，长期专注于制造类 EDA，在芯片成品率提升领域潜心研究十余年，现已形成包括 EDA 软件、WAT 测试设备和半导体大数据平台在内的全流程产品生态。公司创新研发的可寻址测试芯片设计、超高密度阵列、快速电性参数测试技术及大数据分析方法等一系列具备知识产权的核心技术处于业界领先地位。感谢您的关注！

### **31、2023 年公司有什么新的大项目投入运营？**

尊敬的投资者您好，公司将有序推进集成电路成品率技术升级开发项目、集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目、集成电路 EDA 产业化基地项目等募投项目的实施和研发。公司将持续秉承创新、务实、发展的业务理念，不断拓展制造类 EDA 软件及晶圆级电性测试设备领域的技术广度与产品品类，发挥公司产品间的软硬协同优势，持续提升公司的整体市场竞争力，努力提高公司的核心价值和经营业绩，回馈投资者的支持。感谢您对公司的关注！

### **32、面对复杂的国际地缘贸易关系和形势，公司在芯片成品率提升技术层面有哪些创新规划？**

尊敬的投资者您好，公司始终秉承自主创新的理念，掌握关键技术知识产权并打造了成品率提升领域下的全流程覆盖优势；公司积极关注地缘贸易关系的变化，并制定了相关应对措施。在技术上公司从未停止持续创新的脚步，通过与海内外客户深入交流合作不断精进新工艺成品率提升方案，同时深入拓展量产 PCM 方案，将先进监控方法和 EDA 工具从工艺开发环节向量产环节拓展，帮助量产线进一步提高产品成品率；另一方面，着力研发半导体数据分析系统，拟从海量数据的深度关联智能化分析找到影响成品率的根因，进一步提升成品率提升效果；此外，作公司的

电性测试设备作为成品率分析的测试数据来源之一，我们将持续扩展测试设备品类，助力公司解决方案的丰富与完善。

### **33、目前公司股东总数是多少？其中机构户数有多少？**

尊敬的投资者您好！截止 2022 年 12 月 31 日，公司普通股股东总数为 21,094，机构户数为 5,827。感谢您的关注！

### **34、请问公司产品能为芯片制造带来多少良率提升？**

尊敬的投资者您好！在现有产品生态上，公司的成品率解决方案能够在集成电路从设计到量产的产品周期内，应用于工艺开发、新产品导入的工艺评估及量产后的工艺监控场景，帮助实现芯片性能、成品率、稳定性的提升；同时，该解决方案亦能够帮助晶圆厂的新建产线顺利投产、新设备导入并进行海量数据管理与分析工作。综上所述，公司的产品和服务应用于芯片从无到有、从设计至量产的全生命周期，助力各阶段的成品率爬坡。感谢您的关注！

### **35、2022 年公司的研发投入情况如何？**

尊敬的投资者您好！近三年来，公司持续加大研发投入，研发费用率一直保持在 30%以上。2022 年度，公司研发团队达到 248 人，较年初的 139 人增加了 109 人，研发费用额达到 12,353.91 万元，同比增长 88.65%。具体来说，软件产品方面，2022 年度公司持续深化拓展 EDA 产品矩阵布局，面向晶圆厂量产线推出了先进的生产过程监控 (PCM) 方案，并取得了多个 Demo 项目，助力公司 EDA 软件从研发环节拓展至量产环节，突破原有市场空间；另外，在可制造性 (DFM) 设计 EDA 工具方面，公司针对化学机械抛光 (CMP) 工艺，拓展研发 CMP 工艺仿真软件，目前已经取得了初步成果。在半导体数据分析软件开发方面，2022 年公司实现了良率管理与分析系统 YMS、缺陷管理与分析系统 DMS 的开发，配合前期研发的半导体通用数据分析软件、电性测试数据分析软件，已经构建了初具规模的产品矩阵。此外，机器学习等人工智能相关技术的导入取得了较大突破，实现了数据系统高效和智能分析。在电性测试设备方面，为满足 8 寸、6 寸

以及部分 12 寸晶圆厂对设备性价比的需求，2022 年度我们初步完成通用型机台 T4000 机型的优化升级；同时面向晶圆级可靠性测试领域，我们扩展研发了晶圆级可靠性测试（WLR）设备，现已实现关键功能开发，扩充了公司电性测试设备产品线；2023 年 T4000 机型及可靠性测试设备均将投入市场 Demo 验证应用和推广，助力业务持续增长。高强度的研发投入是公司持续创新的动力源泉，也为公司业务的快速发展奠定了基础。感谢您的关注！

### **36、公司目前的财务状况怎样？**

尊敬的投资人您好！截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 351,217.49 万元，负债总额为 32,647.64 万元，所有者权益为 318,569.85 万元，资产负债率为 9.30%，所有者权益比率为 90.70%，更细化的财务指标数据详见公司 2022 年度报告。感谢您的关注！

### **37、2022 年经营业绩的亮点有哪些？如何克服短板？**

尊敬的投资人您好！2022 年度，广立微通过全体员工的不懈努力，顶住了全球地缘贸易关系变化、行业景气度下降等因素的压力，全面实现了营业收入和经营利润的高速增长，向投资人展现了公司优秀的盈利能力和增长态势。2022 年度共计实现营业收入额为 35,559.98 万元，同比增长 79.48%。在净利润方面，2022 年度实现归母净利润 12,237.49 万元，同比增长 91.97%，实现归母扣非净利润 10,271.57 万元，同比增长 104.01%。

从增长速度看，软件业务增长速度略低于硬件业务，造成暂时性的业务平衡性不足。对此，公司持续加大研发投入力度，不断深化拓展 EDA 产品矩阵布局，面向晶圆厂量产线推出了先进的生产过程监控（PCM）方案，并取得了多个 Demo 项目，助力公司 EDA 软件从研发环节拓展至量产环节，突破原有市场空间；另外，在可制造性（DFM）设计 EDA 工具方面，公司针对化学机械抛光（CMP）工艺，拓展研发 CMP 工艺仿真软件，目前已经取得了初步成果。在半导体数据分析软件开发方面，2022 年公司实现了良率管理与分析系统 YMS、缺陷管理与分析系统 DMS 的开发，配

合前期研发的半导体通用数据分析软件、电性测试数据分析软件，已经构建了初具规模的产品矩阵。2022 年，机器学习等人工智能相关技术的导入取得了较大突破，实现了数据系统高效和智能分析。截至目前，公司的数据产品已经进入多家设计、制造及封装厂 Demo 验证，逐渐开始形成订单。随着公司软硬件业务协同效应的逐渐显现，良率提升方案进入量产监控领域，数据软件产品在客户端的 DEMO 验证完成，我们预计软件业务比重将稳步拉升，软硬件业务结构将更趋于平衡。感谢您的关注！

**38、近年来国际形势的变化，以及针对我国芯片行业的卡脖子，贵公司对此有什么影响？贵公司如何应对？**

尊敬的投资者您好！公司始终秉承自主创新的理念，掌握关键技术知识产权并打造了成品率提升领域下的全流程覆盖优势，公司业务运营正常，同时公司积极关注地缘贸易关系的变化，并制定了相关应对措施。感谢您的关注！

**39、请介绍公司的行业地位**

尊敬的投资者您好！在半导体产业链上，成品率提升是非常重要的环节，它关系着设计公司的产品成败和利润率，是晶圆厂的核心竞争力之一。在竞争格局上，公司是海内外极少数能够在成品率提升及电性监控领域提供软硬件一体化、全流程解决方案的企业，在技术先进性、产品的稀缺性和协同作用等方面具备很强的竞争力，公司的解决方案已广泛应用于海内外集成电路设计、制造和封测公司。感谢您的关注！

**40、公司未来如何进一步实现集成电路成品率提升？**

尊敬的投资者您好，集成电路成品率提升是一项非常复杂的系统工程。一般集成电路工艺的生命周期大致包括早期开发、产品导入和量产环节，集成电路制造企业在每个环节不仅需要提升各工艺步骤及产品的成品率，完成 PDK 的建立、验证和产品性能的持续优化，同时还要保证产品的可靠性和制造过程的稳定性。公司的成品率提升技术服务可以针对工艺开发及量产每个阶段的任务、要求和侧重点，设计定制化的测试芯片、测试并分析反

馈，保证客户能够在开发项目全流程中，有针对性的解决问题，协助客户快速完成工艺开发和尽早进入量产阶段，并能够在量产阶段进行高效的生产过程监控，保障成品率与产品品质。公司通过自主研发的 EDA 软件、测试设备硬件、半导体数据分析工具以及成品率提升技术构成的整体解决方案，为在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升，实现了从设计、测试到分析全流程闭环。集成电路产业的快速发展也对成品率提升技术提出了更多的挑战，公司不断精进新工艺成品率提升方案，助力 Chiplet 等新生工艺及特色工艺的开发，保持公司的技术先进性和竞争优势。感谢您的关注！

**41、请问公司哪些专利技术产权是与浙大共有的？**

尊敬的投资人您好！截至目前，公司与浙江大学共有专利共 3 项，分别为一种用于测试半导体生产工艺缺陷的测试芯片及制作方法（ZL200910102099.5）、一种晶体管关键参数的可寻址测试电路及其测试方法（ZL201210492931.9）、一种可选择性配置连接的高密度集成电路测试芯片及其制作方法（ZL201510519666.2）。根据浙江大学科学技术研究院出具的《确认函》，公司有权自行实施共有专利并独自享有由此产生的全部收益。

**42、目前政府正在大力推进数字经济的发展，贵公司如何登上这趟高速列车？**

尊敬的投资者您好，在信息技术快速发展的今天，数字技术与实体经济深度融合为千行百业带来创新和重构，而科技企业作为数字经济发展的重要载体，将在场景应用、平台服务、前沿技术研究等多个维度发挥重要作用。在技术层面上来看，数字经济包括了新兴技术，如大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能和 5G 通信等领域，这些领域的发展离不开集成电路芯片技术。公司是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，提供制造类 EDA 软件、电路 IP、WAT 测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的一站式解决方案，能够为各类集成电路芯片从

设计到量产的整个产品周期内实现各类芯片性能、成品率、稳定性的提升。未来公司将持续秉承自主创新的理念，在制造类 EDA 软件、晶圆级电性测试设备、半导体大数据分析平台等方面加强布局，持续提升公司软硬件一体化方案的能力，铸就更高的技术壁垒。特别是半导体大数据分析平台，该平台是公司在长期的成品率提升业务中看到了数据分析对于集成电路上下游企业的重要价值而着重布局的领域，目前已经取得了阶段性的进展，陆续推出了半导体通用化分析工具 DE-G、集成电路良率管理与分析系统 DE-YMS、集成电路缺陷管理与分析系统 DE-DMS 等产品，面向芯片制造周期开展监控和分析，在集成电路从设计到封测过程中的不同场景下帮助客户进行海量数据的系统化存储、管理与分析，从数据中挖掘出关键价值信息，提高芯片的可制造性，快速定位异常及缺陷，指导工艺改善和良率提升；同时，半导体大数据分析平台对于公司成品率提升的软、硬件系统性解决方案的完善起到举足轻重的作用，能够进一步提升公司的产品与市场竞争力，为公司的业绩提供新的增长引擎。感谢您对公司的关注！

#### **43、目前形势下公司发展的前景怎样？制约瓶颈是什么？**

尊敬的投资者您好，公司以 EDA 软件为起点，围绕成品率提升技术持续布局和拓展产品布局，逐步构建出包括 EDA 软件、WAT 测试设备和半导体大数据平台在内的芯片成品率提升全流程解决方案；从主要专注于工艺开发环节，到目前的工艺开发与量产环节成品率提升方案的全覆盖。我们通过制造类 EDA、半导体数据软件、电性测试设备三大业务板块不断扩大公司业务的市场体量，助力业务持续多年的快速增长。未来，我们将构建贯穿集成电路全产业链的软硬件一体化产品生态，补齐制造类 EDA、完善智能化数据系统产品，同时不断增加电性测试设备品类，极大地扩展公司数据系统客户群体和市场空间，助力公司业务稳定增长。在公司持续发展和规划实施的过程中，面临着集成电路产业发展周期、国际贸易环境不稳定等因素的影响，公司将持续关注行业发展动向，动态调整研发和商业策略，打造具有国际竞争力

	的软硬件产品，持续提高企业核心竞争力和技术水平，努力提高公司的核心价值和经营业绩，回馈投资者的支持。感谢您的关注！
附件清单(如有)	
日期	2023年3月30日